

2024年12月9日

会社名 株式会社 ブイ・テクノロジー  
代表者 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人  
(コード番号：7717 プライム市場)  
問合せ先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾  
(TEL：045-338-1980)

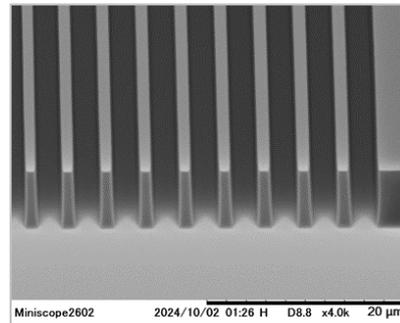
## アドバンスドパッケージ用 DI 露光装置「LAMBDI」初号機を出荷

～インターポージャーやパッケージ基板の微細化に対応する  $L/S=2\mu\text{m}/2\mu\text{m}$  の露光を実現～

株式会社ブイ・テクノロジー（本社：神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134横浜ビジネスパークイーストタワー9F 代表取締役 杉本 重人、以下「当社」）の子会社である、株式会社 LE-TECHNOLOGY（本社：東京都新宿区市谷八幡町2-1 DS 市ヶ谷ビル5F 代表取締役社長 李 梶、以下「LET」）は、インターポージャーおよびパッケージ基板の露光に対応する DI(Direct imaging)露光装置「LAMBDI（ラムディ）」の初号機をこのたび出荷いたしました。



出荷の様子



LAMBDI 露光サンプル  
( $1.2\mu\text{m}$  レジストパターン)

当社グループは、高性能なインターポージャー、パッケージ基板の量産に寄与する技術開発を進めており、LET は、HPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)用パッケージ基板の量産機として、 $4\mu\text{m}$  の描画に対応する「IMAGINA」の初号機をお客様へ2023年に納品いたしました。

「LAMBDI」は、 $2\mu\text{m}$  未満の更に微小な電気回路の露光に対応する先進の露光技術に「IMAGINA」が HPC 用基板の製造現場で培った技術やノウハウを随所に取り入れ、次世代パッケージの量産への寄与を視野に開発された最先端の DI となります。

半導体前工程において、微細化とダイの大型化の両立が物理的にも経済的にも限界を迎えつつある中で、ヘテロロジーニアスパッケージング技術による半導体の高性能化・高集積化・高密度化が急速に進んでいます。

当社グループは、このような技術進化に先駆ける  $L/S=1/1\mu\text{m}$  対応の DI 露光装置の製品化を急いでおり、ガラスを用いた次世代パッケージ基板・インターポージャーの量産に欠かすことができない製品とするべく、年内の開発完了と2025年前半の出荷に向けて、取り組みを更に強化しております。

今後も引き続き、大きいなる志と溢れる情熱で、半導体等の電子デバイスの進化を支える革新的な技術の開発を更に加速する最高のイノベーションを創造し、社会に貢献してまいります。

以上